

Компания СЭА предлагает партнерам и заказчикам выполнение SMD и DIP монтажа любой сложности.

SMD и DIP монтаж компонентов

Эдуард Шепель, г. Киев

Компания СЭА ориентирована как на изготовление опытных образцов, так и на серийное производство изделий. На всю произведенную продукцию дается гарантия качества.

- SMD монтаж осуществляется на автоматическом оборудовании с использованием высококачественных расходных и технологических материалов.
- DIP монтаж выполняется высококвалифицированными специалистами по международным стандартам IPC/JEDEC.

Сборочный участок осуществляет сборку разных по типу, характеру и функциональному назначению изделий любой сложности.

Оборудование для SMD и DIP монтажа компонентов

Современное высокопроизводительное оборудование позволяет осуществлять SMD монтаж печатных плат любой степени сложности в минимальные сроки на 2 автоматизированных линиях (рис.1).



Рис.1

Технологические возможности автоматических SMD линий:

- Размер платы – до 400x460 мм.
- Производительность линии – до 21000 компонентов в час.
- Количество позиций под питатели для ленты 8 мм – 120.
- Диапазон устанавливаемых компонентов:
 - чипы от 0201;
 - микросхемы до 42x42 мм (в том числе и BGA корпуса);
 - min шаг выводов 0.3 мм;
 - максимальная высота компонентов 15 мм;
 - точность установки – чипы ± 50 мкм, QFP ± 30 мкм.

Оборудование для ручного монтажа компонентов

Пайка выводных компонентов осуществляется с помощью паяльных станций производства Weller, таких, как WD2, WR3000M, WMD, 3K и др. Для монтажа используется ручной инструмент производства Erem и Piergiacomini (рис.2).

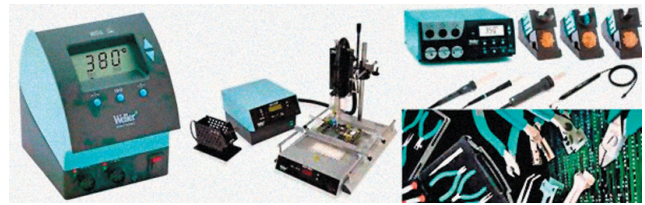


Рис.2

Оборудование для проверки качества паяных соединений

Проверка качества паяных соединений электронных модулей осуществляется на каждой технологической операции монтажа согласно требованиям международного промышленного стандарта IPC-A-610.

Контроль качества монтажа SMD компонентов проводится на автоматизированном оптическом оборудовании Magic Ray, контроль монтажа BGA компонентов с помощью цифрового микроскопа с кратностью x100 Optilia BGA inspection, монтаж выводных компонентов контролируется визуально с помощью инструментального микроскопа и увеличительных линз (рис.3).



Рис.3

Требования к размещению заказа по монтажу компонентов на печатной плате

- Конструкторская документация (спецификация и сборочный чертеж) с указанием требований к монтажу.
- Печатная плата или Gerber-файл для изготовления печатных плат и трафарета.
- Комплектующие изделия в заводских упаковках. При необходимости компания СЭА может оказать помощь в комплектовании изделий заказчика, а также в изготовлении и разводке печатных плат.

Сделать заказ или получить дополнительную информацию можно у ведущего инженера отдела печатных плат по телефону: +380 (044) 291-00-41, или отправив запрос на электронную почту: info@sea.com.ua.